

Title (en)  
METHOD FOR CRIMPING A STONE

Title (de)  
VERFAHREN ZUM FASSEN EINES STEINS

Title (fr)  
PROCEDE DE SERTISSAGE D'UNE PIERRE

Publication  
**EP 3479721 A1 20190508 (FR)**

Application  
**EP 17200365 A 20171107**

Priority  
EP 17200365 A 20171107

Abstract (en)  
[origin: US2019133271A1] A method for assembling a stone on to a mounting, the stone being cut to have a crown, a girdle and a pavilion, the method including providing a substrate including an adhesive layer; positioning the stone on the adhesive layer; heating the adhesive layer; exerting a pressure on the stone; positioning a setting sheet around the stone above the adhesive layer, so as to form a peripheral free space between the setting sheet and the stone, at least at the level of the girdle and of areas of the crown and the pavilion adjacent to the girdle; depositing a metallic layer in the peripheral free space from the setting sheet, at least at the level of the girdle and of the areas of the crown and the pavilion adjacent to the girdle, the metallic layer and the setting sheet forming the mounting; releasing the stone and its mounting from the substrate.

Abstract (fr)  
L'invention se rapporte à un procédé d'assemblage d'une pierre (1) sur un support de fixation, ladite pierre (1) étant taillée pour présenter une couronne (4), un rondiste (5) et une culasse (6), ledit procédé d'assemblage comportant les étapes suivantes: a) se munir d'un substrat (8) comportant une couche adhésive thermofusible (10) b) positionner la pierre (1) sur la couche adhésive thermofusible (10) c) chauffer la couche adhésive thermofusible (10) d) exercer une pression sur la pierre (1) pour pouvoir enfoncer une partie de la couronne (4) dans la couche adhésive thermofusible (10) e) positionner au-dessus de la couche adhésive (10) une feuille de sertissage (12) autour de la pierre (1) pour former entre la feuille de sertissage (12) et ladite pierre (1) un espace libre périphérique (16) au moins au niveau du rondiste (5) et de zones (4a, 6a) de la couronne (4) et de la culasse (6) contiguës au rondiste (5) f) déposer par croissance galvanique dans ledit espace libre périphérique (16), depuis la feuille de sertissage (12), une couche métallique (22) au moins au niveau du rondiste (5) et des zones (4a, 6a) de la couronne (4) et de la culasse (6) contiguës au rondiste (5) de manière à emprisonner ledit rondiste (5) dans ladite couche métallique (22), la couche métallique (22) et la feuille de sertissage (12) formant ledit support de fixation g) libérer ladite pierre (1) et son support de fixation du substrat (8). L'invention concerne également un procédé de sertissage sur un élément d'une pièce d'horlogerie ou de bijouterie d'une pierre et de son support de fixation obtenus selon ledit procédé d'assemblage.

IPC 8 full level  
**A44C 17/04** (2006.01); **C25D 7/00** (2006.01); **G04B 47/04** (2006.01)

CPC (source: EP US)  
**A44C 17/04** (2013.01 - EP US); **A44C 27/00** (2013.01 - US); **C25D 1/003** (2013.01 - EP US); **C25D 5/022** (2013.01 - EP US); **C25D 7/005** (2013.01 - EP US); **G04B 47/042** (2013.01 - EP US)

Citation (applicant)  
DI BARI G.A.: "Electroplating Engineering Handbook", 1984, VAN NOSTRAND REINHOLD COMPAGNY INC., article "electroforming"

Citation (search report)  
• [A] EP 0620987 A1 19941026 - BREUNING FRANZ FA [DE]  
• [A] US 6125516 A 20001003 - WINKLER WILHELM [AT]  
• [A] FR 2717051 A1 19950915 - PGCM CONCEPTION [FR]

Designated contracting state (EPC)  
AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR

Designated extension state (EPC)  
BA ME

DOCDB simple family (publication)  
**EP 3479721 A1 20190508**; **EP 3479721 B1 20200513**; CN 109744667 A 20190514; CN 109744667 B 20210629; JP 2019084350 A 20190606; JP 6666977 B2 20200318; US 10736389 B2 20200811; US 2019133271 A1 20190509

DOCDB simple family (application)  
**EP 17200365 A 20171107**; CN 201811319395 A 20181107; JP 2018201537 A 20181026; US 201816141370 A 20180925